



新榮科技公司

SUN WING TECHNOLOGY COMPANY

九龍塘尾道 54-58 號永利工業大廈二樓 205 室

Room 205, 2/F, Wing Lee Ind. Bldg, 54-58, Tong Mei Rd., Kln, HK

Tel: 2396 2884, 2332 8806 Fax: 2787 4865

E-mail: sunwingt@netvigator.com Web Site: <http://www.sunwingtechnology.com>

焦磷酸銅電鍍工藝

1. 特點：

焦磷酸銅電鍍工藝是經有效改良之焦磷酸銅電鍍法
其特出之性能如下：

1. 鍍層完全光亮，複蓋力強。
2. 填平度高。
3. 鍍液不會侵蝕輕金屬，特點適合於鋅合金，塑膠電鍍件等。
4. 不含氰化物，廢水處理容易。
5. 操作簡易。

2. 優點：

在所有鍍銅運用上，其優點多於一般酸性銅及氰化銅電鍍法：

1. 鋅合金鑄壓件，因鍍液鹼性溫和，故對輕金屬不會有化學侵蝕，超卓複蓋力可確保隱蔽位置亦能有足夠鍍層在鍍鎳及鍍鉻時可保護底層，減少鋅溶於鎳鉻鍍液裏。
2. 銅鐵衝壓件，其優點為具高度填平力鍍銅後可減少或免除鍍前所需之磨光。
3. ABS 塑膠注壓件，高度填平力，全光亮性能及超卓複蓋力，可確保隱蔽位置能有足夠厚度及光亮。
4. 電鑄可鍍上任何厚度而不會形成瘤狀，節省機械加工處理，鍍層具高度機械強度。

3. 配製：

原料	一般開缸份量
焦磷酸銅(含水)	適中 70g/L
純銅濃度	22g/L
焦磷酸鉀(無水)	250g/ L
氨水	2-4ml/L
PC-20	3-6ml/L
PC-21	0.4-0.6ml/L
酸鹼度	8.5-9.0

4·光亮劑之控制和消耗：

要保持鍍層光亮，每日應補充光亮劑一次或多次。每日所需之總補充量，要視乎工作多少以最低消耗量而能保持鍍液操作良好，光亮劑 PC-21 每千安培消耗 170 毫升/升，開缸劑 PC-20 每千安培消耗 150 毫升/升。

5·操作細則：

溫度	50°C-55°C
攪拌	空氣攪拌或搖擺
過濾	連續過濾
陽極	脫氧高導電性電解銅板(粒)
陰極電流密度	1.0-6.0 安培/平方分米
陽極電流密度	0.6-3.3 安培/平方分米
金屬銅	22g/L
焦磷酸根:銅	7:1